

HDIPCB行业市场运行分析及前景趋势与价值评估研究报告(2024-2029版)

报告简介

电子产品向轻薄短小的方向发展的同时，对印制电路板提出了高密度化的要求。HDI(高密度互连板)实现更小的孔径、更细的线宽、更少通孔数量，节约PCB可布线面积、大幅度提高元器件密度、改善射频干扰/电磁波干扰/静电释放等。

从生产工艺角度，普通PCB采用减成法(Subtractive)，HDI在减成法的基础上，通过激光钻微通孔、堆叠的通孔将最小线宽/线距降至40 μ m;因良率问题在30 μ m以下的制程，生产工艺转向半加成法(mSAP)和加成法(SAP)，工艺制程中涉及到更多的镀铜工序，所需镀铜产能大幅增加，并且对于曝光设备(制程更加复杂)以及贴合设备(产品层数增加)的需求也有所增加。

从具体生产流程来看，高阶HDI产品对加工产能的消耗显著增加。HDI阶数由其生产流程中次外层加工环节的重复次数决定，因此同等面积的二阶HDI板产品相比一阶HDI板产品，在次外层加工环节需要使用的压合、减铜、镭射等工序的产能要增加一倍，三阶或任意阶HDI需要的产能为一阶的三倍以上。

早在1956年，国家就将印制电路及其基材列入公布的全国自然科学和社会科学十二年长期规划中。当时的电子部第10研究所，北京的电子部第15研究所，上海的无线电研究所开展了早期研究。在改革开放早期，中国大陆的PCB生产商也主要是台湾、美国及日本投资者在中国设立的合资或外资公司。2004年后，中国大陆逐步成为全球PCB主导国，政府的产业政策逐步向环保、HDI、高频板、高频、高导热、高尺寸稳定性PCB板倾斜。。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国HDIPCB市场进行了分析研究。报告在总结中国HDIPCB发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国HDIPCB的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为HDIPCB企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 hdipcb行业基本概述

第一节 hdipcb行业定义及特点

一、hdipcb简介

二、hdipcb行业特点

第二节 hdipcb行业产业链分析

一、hdipcb行业上游行业介绍

二、hdipcb行业下游行业解析

第三节 hdipcb行业产品种类细分

第四节 hdipcb行业应用领域细分

第五节 hdipcb行业发展驱动因素

第六节 hdipcb行业发展限制因素

第二章 全球及中国hdipcb行业市场运行形势分析

第一节 中国hdipcb行业政治法律环境分析

一、行业相关监管部门

二、行业相关法律法规

第二节 hdipcb行业经济环境分析

一、全球宏观经济形势分析

二、中国宏观经济形势分析

三、hdipcb行业在国民经济中的地位与作用

第三节 hdipcb行业社会环境分析

一、中国人口发展分析

二、中国城镇化发展状况

三、中国居民消费习惯分析

第四节 hdipcb行业技术环境分析

第三章 全球hdipcb行业发展概况分析

第一节 全球hdipcb行业发展现状

一、全球hdipcb行业发展阶段

二、全球hdipcb行业市场规模

第二节 全球各地区hdipcb行业市场份额

第三节 全球hdipcb行业竞争格局

第四节 全球hdipcb行业市场集中度分析

第五节 新冠疫情对全球hdipcb行业的影响

第四章 中国hdipcb行业发展概况分析

第一节 中国hdipcb行业发展现状

一、中国hdipcb行业发展阶段

二、中国hdipcb行业市场规模

三、中国hdipcb行业在全球竞争格局中所处地位

四、“十四五”规划关于hdipcb行业的政策引导

第二节 中国各地区hdipcb行业市场份额

第三节 中国hdipcb行业竞争格局

第四节 中国hdipcb行业市场集中度分析

第五节 中国hdipcb行业发展机遇及挑战

一、国内hdipcb行业发展机遇

二、国内hdipcb行业发展挑战

第六节 新冠疫情对中国hdipcb行业的影响

一、复工延迟导致行业供应下降

二、现金流或告急

三、短期国内下游需求受抑制

第七节 “碳中和”政策对中国hdipcb行业的影响

第五章 全球各地区hdipcb行业发展概况分析

第一节 北美地区hdipcb行业发展概况

一、北美地区hdipcb行业发展现状

二、北美地区hdipcb行业市场规模

第二节 欧洲地区hdipcb行业发展概况

一、欧洲地区hdipcb行业发展现状

二、欧洲地区hdipcb行业市场规模

第三节 亚太地区hdipcb行业发展概况

一、亚太地区hdipcb行业发展现状

二、亚太地区hdipcb行业市场规模

第六章 中国各地区hdipcb行业发展概况分析

第一节 东北地区hdipcb行业发展概况

一、东北地区hdipcb行业发展现状

二、东北地区hdipcb行业发展优势分析

第二节 华北地区hdipcb行业发展概况

一、华北地区hdipcb行业发展现状

二、华北地区hdipcb行业发展优势分析

第三节 华东地区hdipcb行业发展概况

一、华东地区hdipcb行业发展现状

二、华东地区hdipcb行业发展优势分析

第四节 华南地区hdipcb行业发展概况

一、华南地区hdipcb行业发展现状

二、华南地区hdipcb行业发展优势分析

第五节 华中地区hdipcb行业发展概况

一、华中地区hdipcb行业发展现状

二、华中地区hdipcb行业发展优势分析

第六节 西北地区hdipcb行业发展概况

一、西北地区hdipcb行业发展现状

二、西北地区hdipcb行业发展优势分析

第七节 西南地区hdipcb行业发展概况

一、西南地区hdipcb行业发展现状

二、西南地区hdipcb行业发展优势分析

第八节 中国各地区hdipcb行业发展程度分析

第九节 中国hdipcb行业发展主要省市

第七章 中国hdipcb行业产品细分

第一节 中国hdipcb行业产品种类及市场规模

一、中国4-6层hdipcb市场规模

二、中国8-10层hdipcb市场规模

三、中国10+层hdipcb市场规模

第二节 中国hdipcb行业各产品种类市场份额

一、2019-2023年中国各产品种类市场份额

二、2022年中国各产品种类市场份额

第三节 中国hdipcb行业产品价格变动趋势

第四节 影响中国hdipcb行业产品价格波动的因素

一、成本

二、供需情况

三、关联产品

四、其他

第五节 中国hdipcb行业各类型产品优势分析

第八章 中国hdipcb行业应用市场分析

第一节 hdipcb行业应用领域市场规模

一、hdipcb在汽车应用领域市场规模

二、hdipcb在消费电子应用领域市场规模

三、hdipcb在通信应用领域市场规模

四、hdipcb在其他应用领域市场规模

第二节 hdipcb行业应用领域市场份额

一、2019-2023年中国hdipcb在不同应用领域市场份额

二、2022年中国hdipcb在不同应用领域市场份额

第三节 中国hdipcb行业进出口分析

第四节 不同应用领域对hdipcb产品的关注点分析

第五节 各下游应用行业发展对hdipcb行业的影响

第九章 全球和中国hdipcb行业主要企业概况分析

第一节 ibidengroup

一、ibidengroup基本情况

二、ibidengroup主要产品和服务介绍

三、ibidengroup经营情况分析

四、ibidengroup优势分析

第二节 ncabgroup

一、ncabgroup基本情况

二、ncabgroup主要产品和服务介绍

三、ncabgroup经营情况分析

四、ncabgroup优势分析

第三节 bitteleelectronics

一、bitteleelectronics基本情况

二、bitteleelectronics主要产品和服务介绍

三、bitteleelectronics经营情况分析

四、bitteleelectronics优势分析

第四节 ttmtechnologies

- 一、ttmtechnologies基本情况
- 二、ttmtechnologies主要产品和服务介绍
- 三、ttmtechnologies经营情况分析
- 四、ttmtechnologies优势分析

第五节 unimicron

- 一、unimicron基本情况
- 二、unimicron主要产品和服务介绍
- 三、unimicron经营情况分析
- 四、unimicron优势分析

第六节 at&s

- 一、at&s基本情况
- 二、at&s主要产品和服务介绍
- 三、at&s经营情况分析
- 四、at&s优势分析

第七节 semco

- 一、semco基本情况
- 二、semco主要产品和服务介绍
- 三、semco经营情况分析
- 四、semco优势分析

第八节 youngpoonggroup

- 一、youngpoonggroup基本情况
- 二、youngpoonggroup主要产品和服务介绍
- 三、youngpoonggroup经营情况分析

四、youngpoonggroup优势分析

第九节 zdt

一、zdt基本情况

二、zdt主要产品和服务介绍

三、zdt经营情况分析

四、zdt优势分析

第十节 unitechprintedcircuitboard

一、unitechprintedcircuitboard基本情况

二、unitechprintedcircuitboard主要产品和服务介绍

三、unitechprintedcircuitboard经营情况分析

四、unitechprintedcircuitboard优势分析

第十一节 lginnotek

一、lginnotek基本情况

二、lginnotek主要产品和服务介绍

三、lginnotek经营情况分析

四、lginnotek优势分析

第十二节 tripodtechnology

一、tripodtechnology基本情况

二、tripodtechnology主要产品和服务介绍

三、tripodtechnology经营情况分析

四、tripodtechnology优势分析

第十三节 daeduck

一、daeduck基本情况

二、daeduck主要产品和服务介绍

三、daeduck经营情况分析

四、daeduck优势分析

第十四节 hannstarboard

一、hannstarboard基本情况

二、hannstarboard主要产品和服务介绍

三、hannstarboard经营情况分析

四、hannstarboard优势分析

第十五节 nanyapcb

一、nanyapcb基本情况

二、nanyapcb主要产品和服务介绍

三、nanyapcb经营情况分析

四、nanyapcb优势分析

第十六节 cmkcorporation

一、cmkcorporation基本情况

二、cmkcorporation主要产品和服务介绍

三、cmkcorporation经营情况分析

四、cmkcorporation优势分析

第十七节 kingboard

一、kingboard基本情况

二、kingboard主要产品和服务介绍

三、kingboard经营情况分析

四、kingboard优势分析

第十八节 ellington

一、ellington基本情况

二、ellington主要产品和服务介绍

三、ellington经营情况分析

四、ellington优势分析

第十九节 wuzhutechnology

一、wuzhutechnology基本情况

二、wuzhutechnology主要产品和服务介绍

三、wuzhutechnology经营情况分析

四、wuzhutechnology优势分析

第二十节 kinwong

一、kinwong基本情况

二、kinwong主要产品和服务介绍

三、kinwong经营情况分析

四、kinwong优势分析

第二十一节 aoshikang

一、aoshikang基本情况

二、aoshikang主要产品和服务介绍

三、aoshikang经营情况分析

四、aoshikang优势分析

第二十二节 sierracircuits

一、sierracircuits基本情况

二、sierracircuits主要产品和服务介绍

三、sierracircuits经营情况分析

四、sierracircuits优势分析

第二十三节 epec

一、epec基本情况

二、epec主要产品和服务介绍

三、epec经营情况分析

四、epec优势分析

第二十四节 wurthelektronik

一、wurthelektronik基本情况

二、wurthelektronik主要产品和服务介绍

三、wurthelektronik经营情况分析

四、wurthelektronik优势分析

第二十五节 nodelectronics

一、nodelectronics基本情况

二、nodelectronics主要产品和服务介绍

三、nodelectronics经营情况分析

四、nodelectronics优势分析

第十章 hdipcb行业竞争策略分析

第一节 hdipcb行业现有企业间竞争

第二节 hdipcb行业潜在进入者分析

第三节 hdipcb行业替代品威胁分析

第四节 hdipcb行业供应商及客户议价能力

第十一章 全球hdipcb行业市场规模预测

第一节 全球hdipcb行业发展趋势

第二节 全球hdipcb行业市场规模预测

第三节 北美hdipcb行业市场规模预测

第四节 欧洲hdipcb行业市场规模预测

第五节 亚太hdipcb行业市场规模预测

第十二章 中国hdipcb行业发展前景及趋势

第一节 中国hdipcb行业市场发展趋势

第二节 中国hdipcb行业关键技术发展趋势

第三节 中国hdipcb行业市场规模预测

第十三章 hdipcb行业价值评估

第一节 hdipcb行业成长性分析

第二节 hdipcb行业回报周期分析

第三节 hdipcb行业风险分析

第四节 hdipcb行业热点分析

图表目录

图表：hdipcb行业应用领域细分

图表：pcb行业相关法律法规

图表：2001年以来美国和欧元区通胀率走势

图表：2007-2022年新兴市场资金累计流入量

图表：2019-2023年中国gdp增长情况

图表：2019-2023年中国cpi波动情况

图表：2019-2023年中国居民收入情况

图表：2011-2022年全国人口数及自然增长率

图表：2019-2023年居民消费支出情况

图表：2019-2023年全球pcb细分产品结构

图表：2024-2029年全球hdipcb行业市场规模(单位：亿美元)

图表：全球各地区hdipcb行业市场份额

图表：全球智能疏导系统生命周期

图表：2019-2023年中国hdipcb市场规模(单位：亿元)

图表：2019-2023年国内hdipcb区域产能市场份额

图表：2019-2023年国内hdipcb市场集中度cr5对比

图表：2019-2023年北美地区hdipcb市场规模(亿美元)

图表：2019-2023年欧洲地区hdipcb市场规模(亿美元)

图表：2019-2023年亚太地区hdipcb市场规模(亿美元)

图表：2019-2023年东北地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年华北地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年华东地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年华南地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年华中地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年西北地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年西南地区hdipcb市场规模(亿元)

图表：4-6层hdipcb市场规模(亿元)

图表：8-10层hdipcb市场规模(亿元)

图表：10+hdipcb市场规模(亿元)

图表：汽车应用hdipcb市场规模(亿元)

图表：消费电子hdipcb市场规模(亿元)

图表：通信hdipcb市场规模(亿元)

图表：计算机hdipcb市场规模(亿元)

图表：2019-2023年中国hdipcb在不同应用领域市场份额

图表：2019-2023年三星电机主要技术领域的专利分布

图表：2019-2023年三星电机公司的专利份额

图表：全球hdipcb市场规模(亿元)

图表：北美hdipcb市场规模(亿元)

图表：欧洲hdipcb市场规模(亿元)

图表：亚太hdipcb市场规模(亿元)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20221208/309537.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)